

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



香港聯交所股票代號：1347

新聞稿

華虹半導體二零一七年第一季度業績公佈

所有貨幣以美元列帳，除非特別指明。

本合併財務報告系依香港財務報告準則編製。

中國香港 — 2017年5月11日 — 全球領先的200mm純晶圓代工廠華虹半導體有限公司（香港聯交所股票代號：1347）（「本公司」）於今日公佈截至二零一七年三月三十一日止三個月的綜合經營業績。

二零一七年第一季度主要財務指標（未經審核）

- 銷售收入 1.832 億美元，環比減少 5.6%，同比增長 11.4%。
- 毛利率 29.7%，環比下降 1.3 個百分點，同比上升 0.5 個百分點。
- 期內溢利 3,410 萬美元，環比下降 10.8%，同比上升 56.2%。
- 每股盈利 0.03 美元，環比下降 0.01 美元，同比上升 0.01 美元。
- 淨資產收益率 2.3%。

二零一七年第二季度指引

- 我們預計銷售收入環比增長約 8%。
- 我們預計毛利率在 30% 與 31% 之間。

二零一六年度股利派發

- 董事會建議派付截至二零一六年十二月三十一日止年度的末期股息每股 0.30 港元。待股東於五月十一日（周四）召開的股東週年大會上批准後，末期股息將於二零一七年六月十六日（周五）派付予於二零一七年五月二十二日（周一）名列本公司股東名冊的股東。

本公司總裁兼執行董事王煜先生，對第一季度的業績評論道：

“第一季度業務繼續保持強勁勢頭。儘管有季節性因素和兩間工廠年度維護的影響，我們第一季度的業績表現依然穩固。銷售收入達 1.832 億美元，環比減少 5.6%，同比增長 11.4%。產能利用率因年度維護的影響而有所降低，致毛利率環比下降 1.3 個百分點，為 29.7%。淨利潤率達 18.6%。銷售收入和毛利率均超過上季指引。”

“我們充分相信，第二季度又將會有強勁成長，”王煜先生繼續說道，“此刻，我們開足馬力，尤其是在智能卡、MCU、分立器件、模擬和電源管理芯片等領域。目前，智能卡芯片的多家客戶已將產品遷移至我們的 90 納米工藝技術節點，這將是公司未來可持續提供給我們全球客戶的另一競爭力。

電話會議公告

日期：二零一七年五月十二日

時間：下午 04:00（上海 / 香港）
上午 04:00（紐約，2017 年 5 月 12 日，星期五）

廣播：該電話會議將於下述網站進行語音及幻燈片直播：

http://www.huahonggrace.com/s/investor_webcast.php 或

https://engage.vevent.com/rt/huahongsemiconductor~2017_q1_earnings_call

電話詳細：

國際	+65 6713 5521
中國	+86 800 870 0531/+86 400 624 0406
香港	+852 3018 6768
臺灣	+886 277 031 751
紐約	+1 347 549 4095

電話會議登入名：13289314

密碼：HUAHONG

直播約 24 小時後，您可於 12 個月內在 http://www.huahonggrace.com/s/investor_webcast.php 網頁上，重複收聽會議。

關於華虹半導體

本公司是一家全球領先的 200mm 純晶圓代工廠。本公司在上海設有三家晶圓廠，主要專注製造特種應用的晶圓半導體。本公司生產的半導體被廣泛應用於不同市場的各類產品，主要包括電子消費品、通訊、計算機、工業及汽車等。本公司採用自身的專有工藝及技術，為多元化客戶製造符合其設計規格的半導體，本公司亦提供設計支援服務，以便及時完成在工藝的性能、成本及製成品率各方面均達致最優的複雜設計。

如需查詢詳細資訊，請登陸華虹半導體網站 <http://www.huahonggrace.com/>。

經營業績概要
(以千美元為單位，每股盈利和營運數據除外)

	二零一七年 第一季度 (未經審核)	二零一六年 第四季度 (未經審核)	二零一六年 第一季度 (未經審核)	環比	同比
銷售收入	183,236	194,026	164,426	(5.6)%	11.4 %
銷售成本	(128,801)	(133,946)	(116,397)	(3.8)%	10.7 %
毛利	54,435	60,080	48,029	(9.4)%	13.3 %
毛利率	29.7 %	31.0 %	29.2 %	(1.3)	0.5
經營開支	(22,425)	(29,727)	(23,233)	(24.6)%	(3.5)%
其他收入淨額	2,403	14,440	1,943	(83.4)%	23.7 %
稅前溢利	34,413	44,793	26,739	(23.2)%	28.7 %
所得稅開支	(347)	(6,597)	(4,929)	(94.7)%	(93.0)%
期內溢利	34,066	38,196	21,810	(10.8)%	56.2 %
淨利潤率	18.6 %	19.7 %	13.3 %	(1.1)	5.3
每股盈利					
基本	0.03	0.04	0.02	(25.0)%	50.0 %
攤薄	0.03	0.04	0.02	(25.0)%	50.0 %
付運晶圓(仟片)	432	488	391	(11.5)%	10.5 %
產能利用率 ¹	96.2 %	99.5 %	94.7 %	(3.3)	1.5
淨資產收益率 ²	2.3 %	2.6 %	1.4 %	(0.3)	0.9

- 銷售收入 1.832 億美元，環比減少 5.6%，主要由於季節性因素及 1 號和 3 號晶圓廠年度維護的影響。
- 銷售成本 1.288 億美元，環比下降 3.8%，主要由於晶圓銷售量下降所致。
- 毛利率 29.7%，環比下降 1.3 個百分點，主要由於晶圓廠年度維護致產能利用率降低所致。
- 經營開支 2,240 萬美元，環比下降 24.6%，主要由於在上季度(i)計提年終獎金，及(ii)計提設備減值準備所致。
- 其他收入淨額 240 萬美元，環比下降 83.4%，主要由於(i)相比上季度產生大額匯兌收益，本季度發生匯兌損失，及(ii)相比上季度分佔一家聯營公司溢利，本季度分佔該聯營公司損失。
- 所得稅開支 30 萬美元，環比下降 94.7%，主要由於轉回以前年度計提的股利代扣代繳稅金 660 萬美元所致。
- 期內溢利 3,410 萬美元，環比下降 10.8%，同比上升 56.2%。
- 淨利潤率 18.6%，環比下降 1.1 個百分點。
- 每股盈利 0.03 美元。
- 淨資產收益率 2.3%。

¹產能利用率按平均月產量除以總估計月產能計算。

²期內溢利/加權平均淨資產。

銷售收入分析

按類別劃分的 銷售收入	二零一七年 第一季度 仟美元 (未經審核)	二零一七年 第一季度 % (未經審核)	二零一六年 第四季度 仟美元 (未經審核)	二零一六年 第四季度 % (未經審核)	環比 仟美元	環比 %
晶圓	179,109	97.7 %	189,972	97.9 %	(10,863)	(5.7)%
其他	4,127	2.3 %	4,054	2.1 %	73	1.8 %
銷售收入總額	183,236	100.0 %	194,026	100.0 %	(10,790)	(5.6)%

- 本季度 97.7% 的銷售收入來源於半導體晶圓的直接銷售。

銷售收入分析

按地域劃分的 銷售收入	二零一七年 第一季度 仟美元 (未經審核)	二零一七年 第一季度 % (未經審核)	二零一六年 第四季度 仟美元 (未經審核)	二零一六年 第四季度 % (未經審核)	環比 仟美元	環比 %
中國 ³	96,579	52.8 %	106,801	55.1 %	(10,222)	(9.6)%
美國	30,985	16.9 %	33,212	17.1 %	(2,227)	(6.7)%
亞洲 ⁴	26,108	14.2 %	24,821	12.8 %	1,287	5.2 %
歐洲	15,262	8.3 %	17,706	9.1 %	(2,444)	(13.8)%
日本 ⁵	14,302	7.8 %	11,486	5.9 %	2,816	24.5 %
銷售收入總額	183,236	100.0 %	194,026	100.0 %	(10,790)	(5.6)%

- 本季度來自中國的銷售收入 9,660 萬美元，占銷售收入總額的 52.8%，環比減少 9.6%，主要由於通用 MOSFET、模擬和 MCU 產品的需求減少。
- 本季度來自美國的銷售收入 3,100 萬美元，環比減少 6.7%，主要由於 MCU 產品需求減少。
- 本季度來自亞洲的銷售收入 2,610 萬美元，環比增長 5.2%，主要得益於邏輯產品的需求增加。
- 本季度來自歐洲的銷售收入 1,530 萬美元，環比減少 13.8%，主要由於智能卡芯片和通用 MOSFET 產品的需求減少。
- 本季度來自日本的銷售收入 1,430 萬美元，環比增長 24.5%，主要得益於超級結和邏輯產品的需求增加。

³包括香港。

⁴不包括中國及日本。

⁵包括於 2013 年由一家總部位於美國的公司所收購的一家主要日本客戶。

銷售收入分析

按技術平臺劃分的 銷售收入	二零一七年 第一季度 仟美元 (未經審核)	二零一七年 第一季度 % (未經審核)	二零一六年 第四季度 仟美元 (未經審核)	二零一六年 第四季度 % (未經審核)	環比 仟美元	環比 %
嵌入式非易失性存儲器	69,235	37.8 %	73,127	37.7 %	(3,892)	(5.3)%
分立器件	48,341	26.4 %	54,315	28.0 %	(5,974)	(11.0)%
模擬與電源管理	34,523	18.8 %	34,822	17.9 %	(299)	(0.9)%
邏輯及射頻	26,047	14.2 %	25,931	13.4 %	116	0.4 %
獨立非易失性存儲器	4,547	2.5 %	5,439	2.8 %	(892)	(16.4)%
其他	543	0.3 %	392	0.2 %	151	38.5 %
銷售收入總額	183,236	100.0 %	194,026	100.0 %	(10,790)	(5.6)%

- 本季度嵌入式非易失性存儲器銷售收入 6,920 萬美元，環比減少 5.3%，主要由於 MCU 產品需求減少，部分被智能卡芯片需求增加所抵消。
- 本季度分立器件銷售收入 4,830 萬美元，環比減少 11.0%，主要由於通用 MOSFET 和 IGBT 產品需求減少，部分被超級結產品需求增加所抵消。
- 本季度獨立非易失性存儲器銷售收入 450 萬美元，環比減少 16.4%，主要由於 MCU 產品的需求減少。

銷售收入分析

按工藝技術節點 劃分的銷售收入	二零一七年 第一季度 仟美元 (未經審核)	二零一七年 第一季度 % (未經審核)	二零一六年 第四季度 仟美元 (未經審核)	二零一六年 第四季度 % (未經審核)	環比 仟美元	環比 %
0.13μm 及以下	61,303	33.5 %	66,588	34.3 %	(5,285)	(7.9)%
0.15μm 及 0.18μm	32,075	17.5 %	34,069	17.6 %	(1,994)	(5.9)%
0.25μm	3,095	1.7 %	4,590	2.4 %	(1,495)	(32.6)%
0.35μm 及以上	86,763	47.3 %	88,779	45.7 %	(2,016)	(2.3)%
銷售收入總額	183,236	100.0 %	194,026	100.0 %	(10,790)	(5.6)%

- 本季度 0.13μm 及以下工藝技術節點的銷售收入 6,130 萬美元，環比減少 7.9%，主要由於 MCU 產品需求減少。
- 本季度 0.15μm 及 0.18μm 工藝技術節點的銷售收入 3,210 萬美元，環比減少 5.9%，主要由於 MCU 產品需求減少。
- 本季度 0.25μm 工藝技術節點的銷售收入 310 萬美元，環比減少 32.6%，主要由於通用 MOSFET 產品需求減少。
- 本季度 0.35μm 及以上工藝技術節點的銷售收入 8,680 萬美元，環比減少 2.3%，主要由於通用 MOSFET 產品需求減少，部分被智能卡芯片的需求增加所抵消。

銷售收入分析

按終端市場分佈劃分的銷售收入	二零一七年 第一季度 仟美元 (未經審核)	二零一七年 第一季度 % (未經審核)	二零一六年 第四季度 仟美元 (未經審核)	二零一六年 第四季度 % (未經審核)	環比 仟美元	環比 %
電子消費品	128,654	70.3%	134,437	69.3 %	(5,783)	(4.3)%
通訊	23,145	12.6%	27,119	14.0 %	(3,974)	(14.7)%
工業及汽車	22,025	12.0%	21,775	11.2 %	250	1.1 %
計算機	9,412	5.1%	10,695	5.5 %	(1,283)	(12.0)%
銷售收入總額	183,236	100.0%	194,026	100.0 %	(10,790)	(5.6)%

- 電子消費品及通訊仍是我們的第一及第二大終端市場分佈，本季度合計貢獻 82.9%的銷售收入，上一季度為 83.3%
- 本季度電子消費品銷售收入 1.287 億美元，環比減少 4.3%，主要由於通用 MOSFET 產品需求減少。
- 本季度通訊產品銷售收入 2,310 萬美元，環比減少 14.7%，主要由於智能卡芯片和 MCU 產品需求減少。
- 本季度計算機產品銷售收入 940 萬美元，環比減少 12.0%，主要由於 MCU 及通用 MOSFET 產品需求減少。

產能⁶及產能利用率

晶圓廠(仟片晶圓每月)	二零一七年 第一季度 (未經審核)	二零一六年 第四季度 (未經審核)	二零一六年 第一季度 (未經審核)
1 號晶圓廠	56	56	56
2 號晶圓廠	57	57	50
3 號晶圓廠	42	42	40
合計	155	155	146
<i>產能利用率</i>	96.2%	99.5%	94.7%

- 產能利用率由上季度的 99.5%下降至本季度的 96.2%，主要由於 1 號和 3 號晶圓廠年度維護的影響。

⁶ 期末月產能，且為比較目的，以 30 天作為計算基礎。

付運晶圓

仟片晶圓	二零一七年 第一季度 (未經審核)	二零一六年 第四季度 (未經審核)	二零一六年 第一季度 (未經審核)	環比	同比
付運晶圓	432	488	391	(11.5)%	10.5 %

- 本季度付運晶圓 432 仟片，環比減少 11.5%，主要由於季節性因素及晶圓廠年度維護的影響。

經營開支分析

以千美元計	二零一七年 第一季度 (未經審核)	二零一六年 第四季度 (未經審核)	二零一六年 第一季度 (未經審核)	環比	同比
銷售及分銷費用	1,500	2,003	1,457	(25.1)%	3.0 %
管理費用 ⁷	20,925	27,724	21,776	(24.5)%	(3.9)%
經營開支	22,425	29,727	23,233	(24.6)%	(3.5)%

- 經營開支 2,240 萬美元，環比下降 24.6%，主要由於在上季度(i)計提年終獎金，及(ii)計提設備減值準備所致。

其他收入淨額分析

以千美元計	二零一七年 第一季度 (未經審核)	二零一六年 第四季度 (未經審核)	二零一六年 第一季度 (未經審核)	環比	同比
租金收入	3,049	3,772	3,196	(19.2)%	(4.6)%
利息收入	1,445	1,367	1,310	5.7 %	10.3 %
匯兌(損失)/收益	(1,353)	6,024	(1,563)	(122.5)%	(13.4)%
分佔一家聯營公司(損失)/溢利	(298)	3,871	(452)	(107.7)%	(34.1)%
財務費用	(515)	(874)	(984)	(41.1)%	(47.7)%
政府補貼	384	320	203	20.0 %	89.2 %
其他	(309)	(40)	233	672.5 %	(232.6)%
其他收入淨額	2,403	14,440	1,943	(83.4)%	23.7 %

- 其他收入淨額 240 萬美元，環比下降 83.4%，主要由於(i)相比上季度產生大額匯兌收益，本季度發生匯兌損失，及(ii)相比上季度分佔一家聯營公司溢利，本季度分佔該聯營公司損失。

⁷管理費用包括確認為研發開支抵銷項目的政府補助。

現金流量分析

以千美元計	二零一七年 第一季度 (未經審核)	二零一六年 第四季度 (未經審核)	二零一六年 第一季度 (未經審核)	環比	同比
經營活動所得現金流量淨額	30,049	84,319	36,056	(64.4)%	(16.7)%
投資活動所用現金流量淨額	(44,456)	(23,060)	(2,240)	92.8 %	(1,884.6)%
融資活動所用現金流量淨額	(512)	(86,424)	(969)	(99.4)%	(47.2)%
外匯匯率變動影響淨額	1,452	(8,766)	2,591	(116.6)%	(44.0)%
現金及現金等價物變動影響淨額	(13,467)	(33,931)	35,438	(60.3)%	(138.0)%

- 本季度經營活動所得現金流量淨額 3,000 萬美元，環比下降 64.4%，主要由于(i)貿易應收款項及應收票據的回收減少，(ii)支付年終獎金，及(iii)在上一季度從一家關聯公司收回應收廠房租賃款。
- 本季度投資活動所用現金流量淨額 4,450 萬美元，其中包括(i)設備投資支出 4,090 萬美元，(ii)定期存款投資支出 500 萬美元，部分被利息收入 140 萬美元所抵消。
- 本季度融資活動所用現金流量淨額 50 萬美元，為銀行貸款利息支出。

資本結構

以千美元計	於三月三十一日 二零一七年 (未經審核)	於十二月三十一日 二零一六年 (未經審核)
資產總額	1,867,537	1,826,664
負債總額	335,805	337,978
所有者權益總額	1,531,732	1,488,686
資產負債率 ⁸	18.0%	18.5%

資本開支

以千美元計	二零一七年 第一季度 (未經審核)	二零一六年 第四季度 (未經審核)
資本開支	40,942	24,243

- 本季度資本開支 4,090 萬美元，上季度為 2,420 萬美元。

⁸ 資產負債率=負債總額/資產總額。

流動性分析

以千美元計	於三月三十一日 二零一七年 (未經審核)	於十二月三十一日 二零一六年 (未經審核)
存貨	96,038	95,199
貿易應收款項及應收票據	109,026	106,078
預付款項、按金及其他應收款項	13,960	8,963
應收關聯方款項	53,625	37,752
已凍結存款及定期存款	130,341	125,547
現金及現金等價物	327,788	341,255
流動資產總額	730,778	714,794
貿易應付款項	62,172	64,790
其他應付款項、預收賬款及暫估費用	98,913	101,507
計息銀行借款	1,884	1,874
政府補助	38,176	35,863
應付關聯方款項	9,455	9,689
應付所得稅	30,269	24,222
流動負債總額	240,869	237,945
淨營運資金	489,909	476,849
速動比率	2.6x	2.6x
流動比率	3.0x	3.0x
貿易應收款項及應收票據周轉天數	59	56
存貨周轉天數	67	65

- 預付款項、按金及其他應收款項由上季度末的 900 萬美元上升至本季度末的 1,400 萬美元，主要由於對供應商的預付款增加。
- 應收關聯方款項由上季度末的 3,780 萬美元上升至本季度末的 5,360 萬美元，主要由於(i)來自兩家關聯方的貿易及其他應收款項增加，及(ii)本季度對一家關聯方發生預付款。
- 應付所得稅由上季度末的 2,420 萬美元上升至本季度末的 3,030 萬美元，主要由於本季度計提所得稅開支所致。
- 本季度末淨營運資金 4.899 億美元，流動比率 3.0。
- 本季度貿易應收款項及應收票據周轉天數 59 天。
- 本季度存貨周轉天數為 67 天。

上述公佈詳情請參閱華虹半導體網站 www.huahonggrace.com

華虹半導體有限公司
簡明損益表(以千美元計,每股盈利和股數除外)

	截至以下日期止三個月		
	於三月三十一日 二零一七年 (未經審核)	於十二月三十一日 二零一六年 (未經審核)	於三月三十一日 二零一六年 (未經審核)
銷售收入	183,236	194,026	164,426
銷售成本	(128,801)	(133,946)	(116,397)
毛利	54,435	60,080	48,029
其他收入及收益	5,081	12,034	4,942
投資物業的公平值收益	-	72	-
銷售及分銷費用	(1,500)	(2,003)	(1,457)
管理費用	(20,925)	(27,724)	(21,776)
其他費用	(1,865)	(663)	(1,563)
財務費用	(515)	(874)	(984)
分佔一家聯營公司(損失)/溢利	(298)	3,871	(452)
稅前溢利	34,413	44,793	26,739
所得稅開支	(347)	(6,597)	(4,929)
期內溢利	34,066	38,196	21,810
以下各方應佔利潤:			
母公司擁有人	34,066	38,196	21,810
非控股權益	-	-	-
持有人應佔每股盈利			
基本	0.03	0.04	0.02
攤薄	0.03	0.04	0.02
用於計算每股基本盈利的期內已發行普通股加權平均數	1,033,871,656	1,033,871,656	1,033,871,656
用於計算每股攤薄盈利的期內已發行普通股加權平均數	1,041,332,656	1,040,365,656	1,034,276,656

華虹半導體有限公司
簡明綜合財務狀況表(以千美元計)

	截至		
	於三月三十一日 二零一七年 (未經審核)	於十二月三十一日 二零一六年 (已審核)	於三月三十一日 二零一六年 (未經審核)
資產			
非流動資產			
物業、廠房及設備	678,861	656,517	651,898
投資物業	169,997	169,074	181,447
預付土地租賃款項	20,021	20,071	22,060
無形資產	8,226	8,176	8,146
於聯營公司的投資	45,070	45,121	40,582
可供出售投資	204,441	203,330	218,303
長期預付款項	4,065	3,861	12,960
遞延稅項資產	6,078	5,720	5,250
非流動資產總額	1,136,759	1,111,870	1,140,646
流動資產			
存貨	96,038	95,199	102,361
貿易應收款項及應收票據	109,026	106,078	102,164
預付款項、按金及其他應收款項	13,960	8,963	8,904
應收關聯方款項	53,625	37,752	35,069
已凍結存款及定期存款	130,341	125,547	1,022
現金及現金等價物	327,788	341,255	545,879
流動資產總額	730,778	714,794	795,399
流動負債			
貿易應付款項	62,172	64,790	57,824
其他應付款項、預收賬款及暫估費用	98,913	101,507	77,396
計息銀行借款	1,884	1,874	42,750
政府補助	38,176	35,863	57,558
應付關聯方款項	9,455	9,689	8,710
應付所得稅	30,269	24,222	26,288
流動負債總額	240,869	237,945	270,526
流動資產淨額	489,909	476,849	524,873
總資產減流動負債	1,626,668	1,588,719	1,665,519
非流動負債			
計息銀行借款	90,946	90,757	138,067
遞延稅項負債	3,990	9,276	6,242
非流動負債總額	94,936	100,033	144,309
淨資產	1,531,732	1,488,686	1,521,210
權益和負債權益			
股本	1,550,164	1,550,164	1,550,164
儲備	(18,432)	(61,478)	(28,954)
權益總額	1,531,732	1,488,686	1,521,210

華虹半導體有限公司
簡明綜合現金流量表(以千美元計)

	截至以下日期止三個月		
	於三月三十一日 二零一七年 (未經審核)	於十二月三十一日 二零一六年 (未經審核)	於三月三十一日 二零一六年 (未經審核)
經營活動所得現金流量:			
稅前溢利	34,413	44,793	26,739
折舊及攤銷	23,541	23,512	19,917
應佔聯營公司虧損/(溢利)	298	(3,871)	452
營運資金的變動及其它	(28,203)	19,885	(11,052)
經營活動所得現金流量淨額	30,049	84,319	36,056
投資活動所用現金流量:			
購買物業、廠房及設備項目	(40,942)	(24,243)	(43,159)
其他投資活動所(用)/得的現金流量	(3,514)	1,183	40,919
投資活動所用現金流量淨額	(44,456)	(23,060)	(2,240)
融資活動所用現金流量:			
償還銀行貸款	-	(85,500)	-
向股東支付股息	-	(4)	-
已凍結存款的減少	-	4	-
已付利息	(512)	(924)	(969)
融資活動所用現金流量淨額	(512)	(86,424)	(969)
現金及現金等價物(減少)/增加淨額	(14,919)	(25,165)	32,847
外匯匯率變動影響淨額	1,452	(8,766)	2,591
期初現金及現金等價物	341,255	375,186	510,441
期末現金及現金等價物	327,788	341,255	545,879

於本公告日期，本公司董事分別為：

執行董事

張素心(董事長)

王煜(總裁)

非執行董事

陳劍波

馬玉川

森田隆之

葉峻

獨立非執行董事

張祖同

王桂壩太平紳士

葉龍蜚

承董事會命

華虹半導體有限公司

張素心

董事長兼執行董事

中國 香港

二零一七年五月十一日